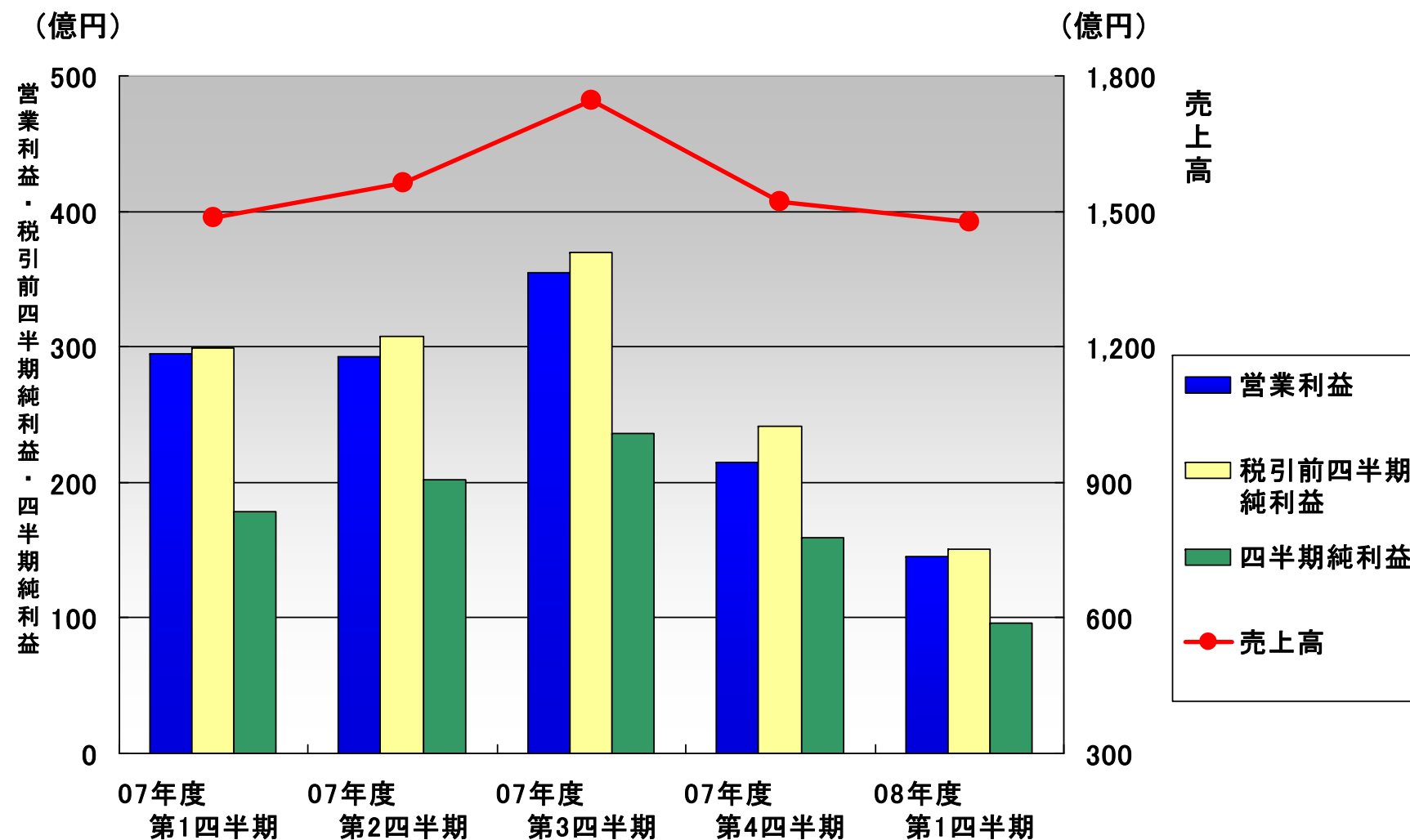


2008年度 第1四半期決算説明会

2008年7月29日
株式会社村田製作所

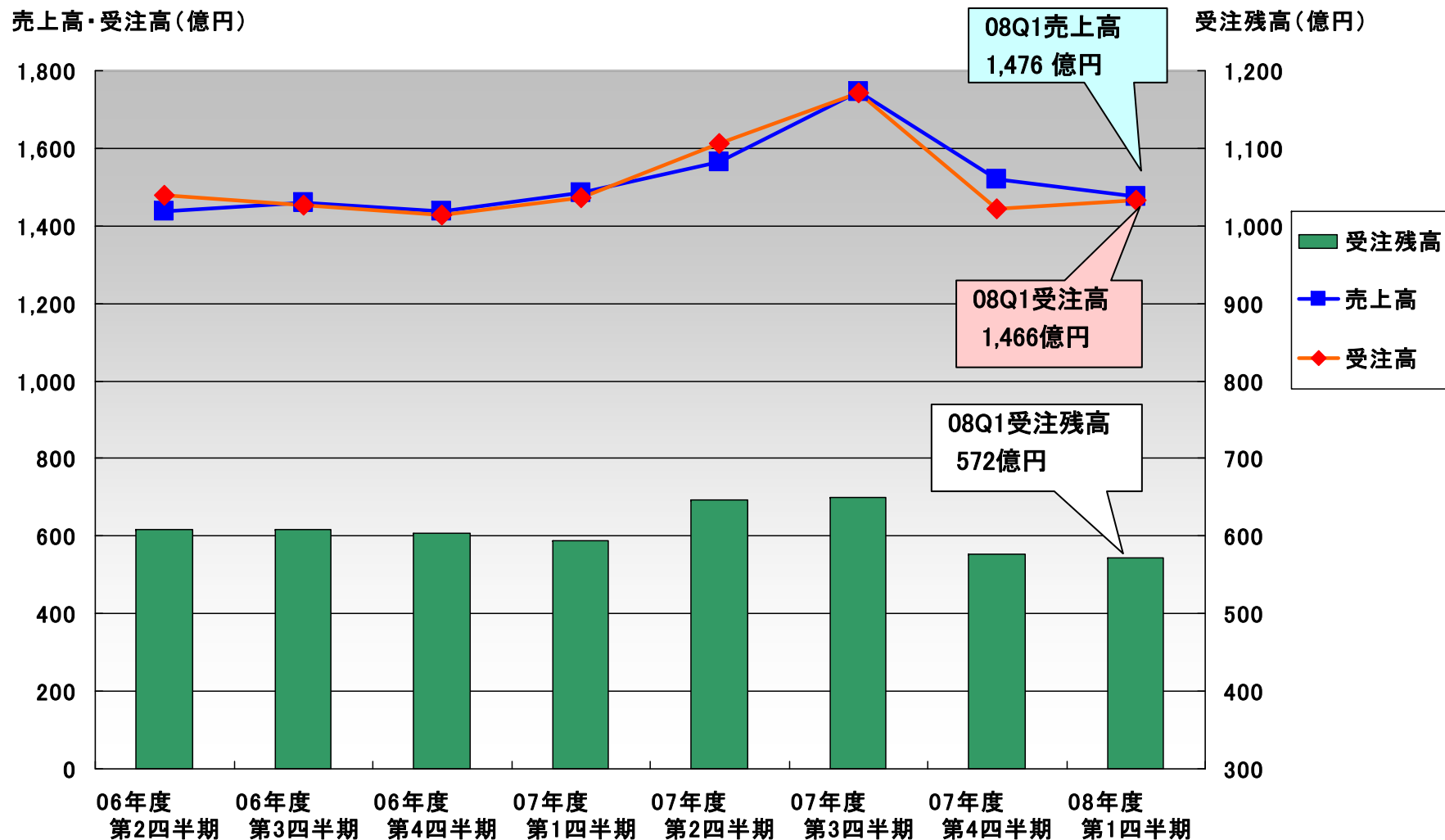


業績概要

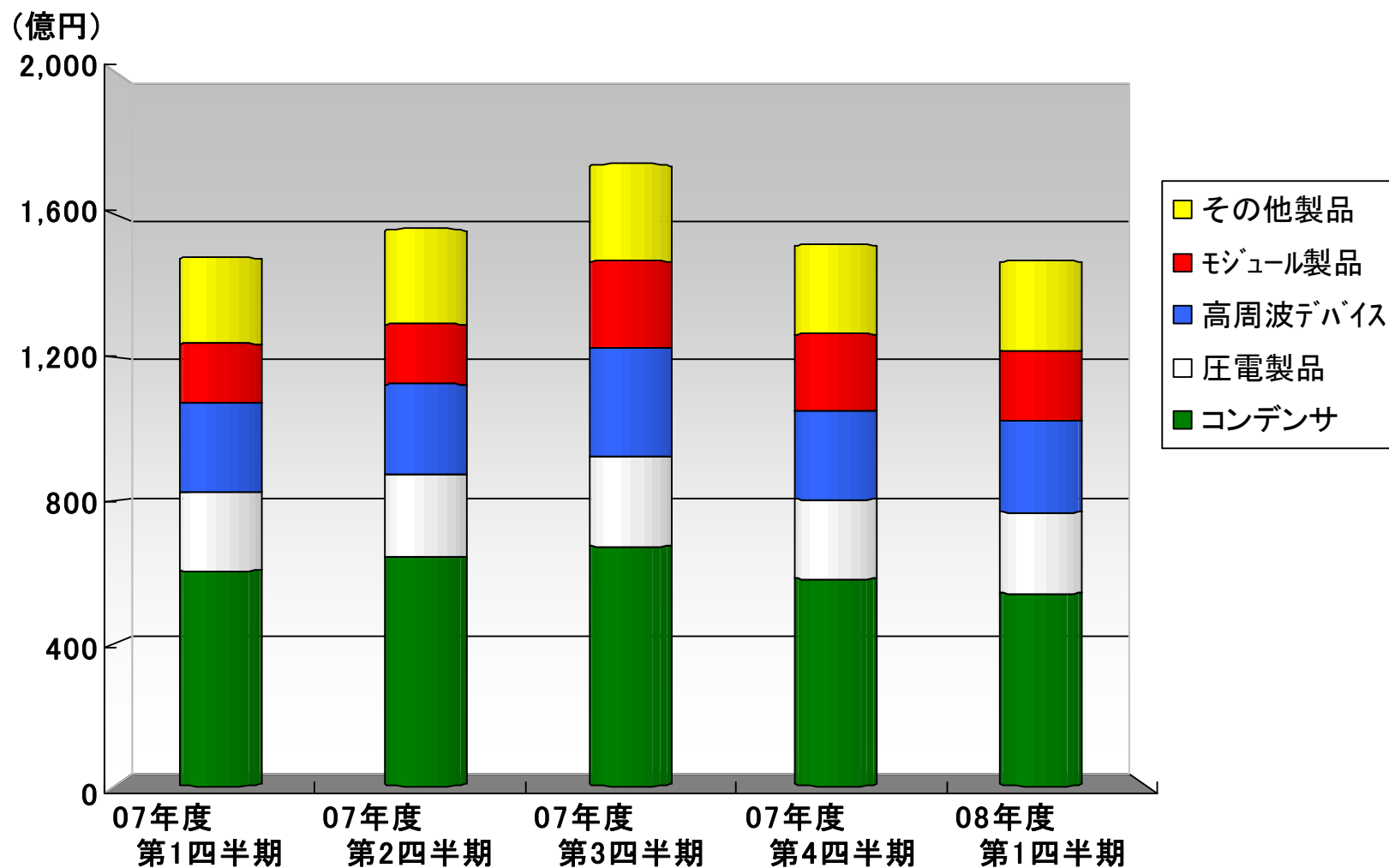


四半期の売上・受注・注残推移

売上高・受注高(億円)



製品別売上高推移



製品別売上高

	2007年度 第1四半期		2008年度 第1四半期		増減	
	(億円)	(%)	(億円)	(%)	(億円)	(%)
コンデンサ	601	40.6	539	36.6	▲62	▲10.4
圧電製品	223	15.0	227	15.4	+4	+1.8
高周波デバイス	251	17.0	258	17.6	+7	+3.0
モジュール製品	163	11.0	196	13.3	+32	+19.7
その他製品	243	16.4	252	17.1	+9	+3.6
製品売上高計	1,481	100.0	1,471	100.0	▲10	▲0.7

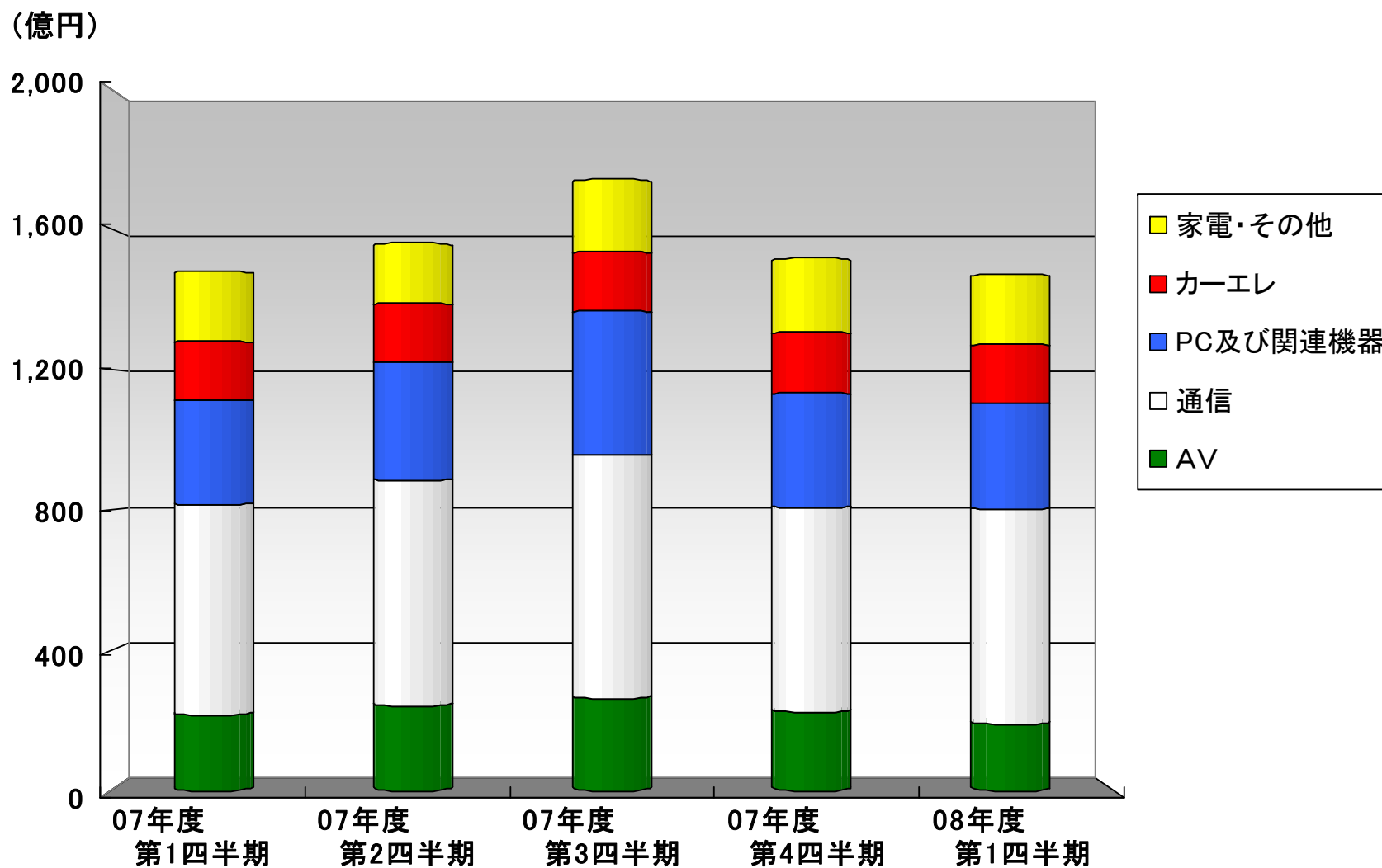
製品別売上高

コンデンサ (前年同期比▲10.4%)	<ul style="list-style-type: none">・チップ積層セラミックコンデンサ: 大容量品が大幅に減少・用途特化型品: PC及び関連機器向けに大幅に減少
圧電製品 (前年同期比+1.8%)	<ul style="list-style-type: none">・表面波フィルタ: 通信機器向けに伸長・圧電センサ: HDD向け、カーエレ向けに大幅に増加・セラミック発振子: AV機器向けやカーエレ向けに減少・セラミックフィルタ: 通信機器向けやカーエレ向けに大幅に減少
高周波デバイス (前年同期比+3.0%)	<ul style="list-style-type: none">・多層デバイス、アイソレータ: 通信機器向けに大幅に増加・近距離無線通信モジュール: Bluetooth®モジュールの減少を無線LANモジュールの増加でカバーできずトータルで減少
モジュール製品 (前年同期比+19.7%)	<ul style="list-style-type: none">・回路モジュール: 通信機器用モジュールが減少、携帯電話用の地上デジタルチューナが大幅に増加・電源: MPSの売上計上(07年3Qより連結)
その他製品 (前年同期比+3.6%)	<ul style="list-style-type: none">・チップコイル: 通信機器向けに大きく伸長・EMI除去フィルタ: 通信機器向けに増加、AV機器向けに減少

(注) Bluetoothは米国Bluetooth SIG, Inc.の商標です

(注) MPS: Murata Power Solutions (07年8月米国C&Dテクノロジーズ社より買収したPower Electronics 事業部)

用途別売上高推移



用途別売上高

	2007年度 第1四半期		2008年度 第1四半期		増減	
	(億円)	(%)	(億円)	(%)	(億円)	(%)
AV	217	14.6	188	12.8	▲29	▲13.2
通信	598	40.4	615	41.8	+17	+2.8
PC及び関連機器	298	20.2	300	20.4	+2	+0.5
カーエレ	165	11.2	168	11.4	+3	+1.7
家電・その他	202	13.6	199	13.6	▲2	▲1.2
製品売上高計	1,481	100.0	1,471	100.0	▲10	▲0.7

用途別売上高

AV機器 (前年同期比▲13.2%)	<ul style="list-style-type: none">・ゲーム機、DSC向けが大幅に減少・薄型テレビ向けは横ばい
通信 (前年同期比+2.8%)	<ul style="list-style-type: none">・第3世代機向けや無線LAN向けに大幅に伸長 →表面波フィルタ、多層デバイス、無線LAN用モジュール、携帯電話用の地上デジタルチューナ等が増加
PC及び関連機器 (前年同期比+0.5%)	<ul style="list-style-type: none">・HDD向けの衝撃検知用センサが大幅に増加・MPU向けは低ESLコンデンサが減少・サーバー・産業用機器向けでMPS売上が寄与
カーエレ (前年同期比+1.7%)	<ul style="list-style-type: none">・カーナビ向け、ソナー向け、防犯装置向けなどが増加

業績概況

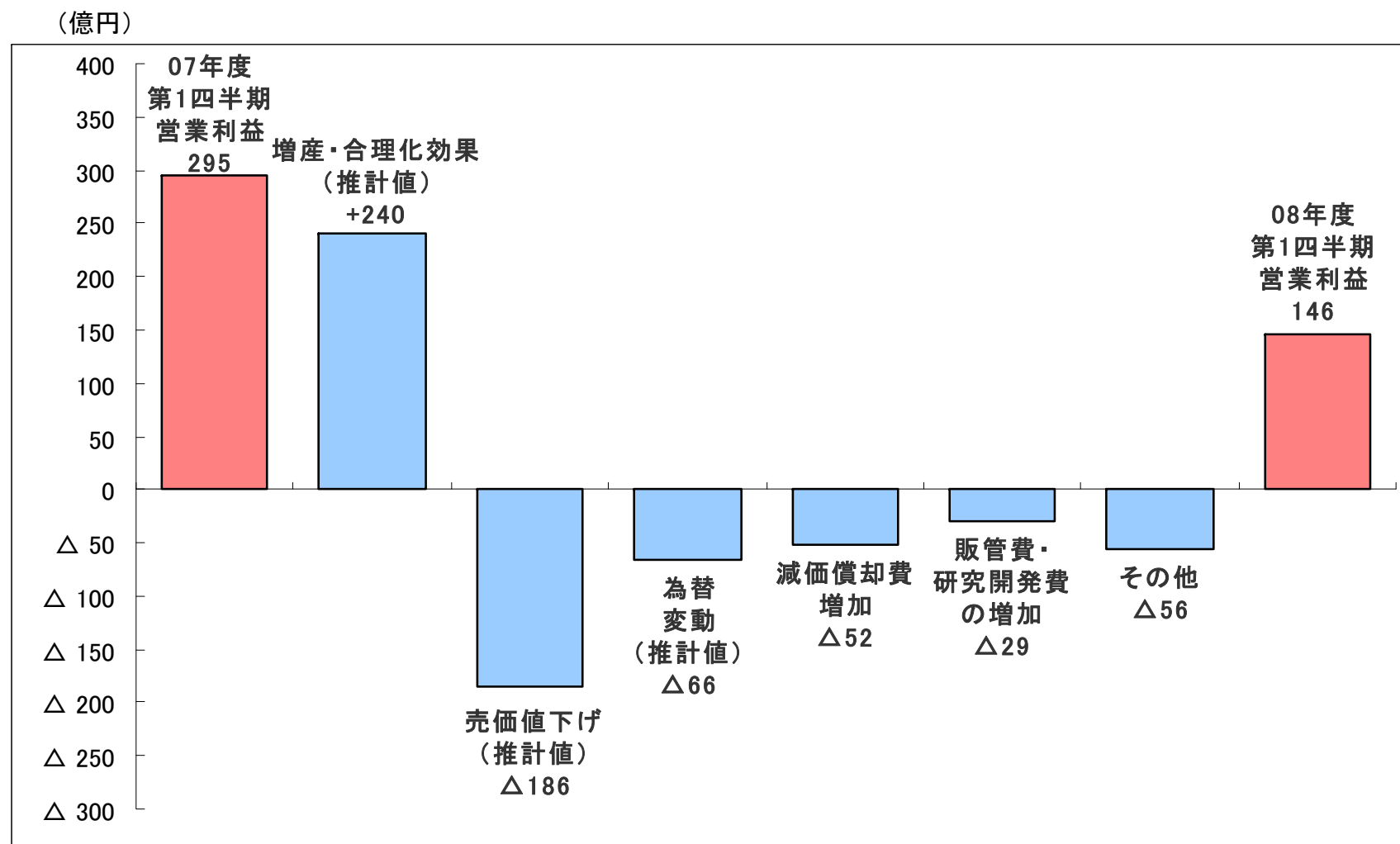


	2007年度 第1四半期		2008年度 第1四半期		増減	
	(億円)	(%)	(億円)	(%)	(億円)	(%)
売上高	1,485	100.0	1,476	100.0	▲9	▲0.6
営業利益	295	19.8	146	9.9	▲149	▲50.6
税引前利益	299	20.1	151	10.2	▲148	▲49.5
当期純利益	178	12.0	96	6.5	▲82	▲46.1

(参考)

減価償却費	134	9.0	186	12.6	+52	+38.7
償却前営業利益	429	28.9	332	22.5	▲97	▲22.7

2008年度第1四半期営業利益変動要因



2008年度の業績予想

	従来予想				今回予想			
	2008年度				2008年度			
	上期予想	下期予想	通期予想		上期予想	下期予想	通期予想	
	(億円)	(億円)	(億円)	(%)	(億円)	(億円)	(億円)	(%)
売上高	3,200	3,400	6,600	+4.5	3,100	3,300	6,400	+1.3
営業利益	370	430	800	▲30.9	310	390	700	▲39.5
税引前利益	395	455	850	▲30.2	325	425	750	▲38.4
当期純利益	250	280	530	▲31.5	205	260	465	▲39.9
(参考)								
減価償却費	350	400	750	+17.0	385	415	800	+24.8
償却前営業利益	720	830	1,550	▲13.8	695	805	1,500	▲16.6

※(%)は前期比伸び率

※四半期別売上高

Q1実績:1,476億円、Q2:1,624億円、Q3:1,735億円、Q4:1,565億円

用途別売上予想

	2007年度 実績	2008年度 従来予想 (08/4予想)	2008年度 今回予想
AV	+26.8%	+3%程度	▲3%程度
通信 計 (うち携帯電話)	+9.4% (+9.5%)	+10%程度 (+13%程度)	+7%程度 (+8%程度)
PC及び関連機器	+16.6%	横ばい	▲3%程度
カーエレ	+9.6%	+5%程度	+3%程度
家電・その他	▲2.8%	▲5%程度	▲5%程度

製品別売上予想

	2007年度 実績	2008年度 従来予想 (08/4予想)	2008年度 今回予想
コンデンサ	+15.9%	+2%程度	▲5%程度
圧電製品	+13.7%	+8%程度	+5%程度
高周波デバイス	▲7.6%	+15%程度	+15%程度
モジュール (MPS除く)	+33.3% (+15.2%)	+3%程度 (▲5%程度)	▲3%程度 (▲10%程度)
その他	+8.8%	横ばい	+3%程度

当資料に記載されている、当社又は当社グループに関する見通し、計画、方針、戦略、予定、判断などのうち既に確定した事実でない記載は、将来の業績に関する見通しです。将来の業績の見通しは、現時点で入手可能な情報と合理的と判断する一定の前提に基づき当社グループが予測したものです。実際の業績は、さまざまなリスク要因や不確実な要素により業績見通しと大きく異なる可能性があり、これらの業績見通しに過度に依存しないようお願いいたします。また、新たな情報、将来の現象、その他の結果に関わらず、当社が業績見通しを常に見直すとは限りません。実際の業績に影響を与えるリスク要因や不確実な要素には、以下のものが含まれます。(1)当社の事業を取り巻く経済情勢、電子機器及び電子部品の市場動向、需給環境、価格変動、(2)原材料等の価格変動及び供給不足、(3)為替レートの変動、(4)変化の激しい電子部品市場の技術革新に対応できる新製品を安定的に提供し、顧客が満足できる製品やサービスを当社グループが設計、開発し続けていく能力、(5)当社グループが保有する金融資産の時価の変動、(6)各国における法規制、諸制度及び社会情勢などの当社グループの事業運営に係る環境の急激な変化、(7)偶発事象の発生、などです。ただし、業績に影響を与える要素はこれらに限定されるものではありません。

当資料に記載されている将来予想に関する記述についてこれらの内容を更新し公表する責任を負いません。